



切割/研磨/精磨一体机 SGL 200



简介

SGL 200 可独立完成薄片制备时的切割、研磨、精磨程序。一个高级不锈钢精磨盘，金刚石制锯片，金刚石制磨轮，及可满足多种尺寸岩样的真空卡盘是此设备的主要组成部分。后部的卡盘在进行切割和研磨时，牢牢的固定住岩样。通过一个手动旋转盘，可将切割好的岩样直接传送到磨轮，以减少工序并节约时间。一个可调旋钮控制薄片的切割厚度，一个千分尺控制薄片的研磨厚度。在进行手动精磨时，要先往研磨盘上涂上碳化硅溶剂。

参数

岩样尺寸：两个岩样 30x45mm/1”x1.5”

一个岩样 60x45mm/1”x3”

锯片：φ 200mm

磨轮：直杯型砂轮，φ 200，Grit 46

研磨盘直径：φ 200mm

研磨盘转速：150RPM

润滑剂：水

电机转速：3000RPM

重量：50kg

尺寸：640x340x350mm

电源：220V，50/60Hz

特点

切/磨/精磨一体

操作简单，耐用

切割、研磨、精磨迅速，且精度高